

Pressemitteilung

12.12.2019

## Kompakte Board-to-Board Lösungen im Rastermaß 1,27mm



W+P erweitert sein etabliertes Board-to-Board (B-t-B) Programm um fünf Serien, bestehend aus vier Steckverbinder-Serien und eine Kabelkonfektion in Schneidklemmtechnik. Während die Serien 9017 bis 9020 unter anderem flexibles Anordnen von Leiterplatten gestatten, ermöglicht die vorkonfektionierte Serie 998-916 einen sicheren Anschluss, der auch mechanischen Belastungen standhält.

So bieten die SMT Stift- und Buchsenleisten der **Serien 9017 bis 9020** vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Leiterplatten: Vertikales und horizontales Verbinden von Platinen, ebenso ist ein Mix aus einer stehenden und liegenden Variante möglich, die eine rechtwinkelige Anordnung erzeugt. Zusätzliche seitliche Lötwinkel sorgen für eine solide Befestigung auf der Leiterkarte.

Insgesamt stehen 10 verschiedene Polzahlen zwischen 12 und 80 Kontakten zur Verfügung. Als Kontaktmaterial wird eine Kupferlegierung mit den Oberflächenoptionen von Flash vergoldet bis zu einer Beschichtung von 0,75 µm Gold angeboten.

Die Isolierkörper bestehen aus thermoplastischem Kunststoff gemäß UL94 V-0.

Eine sichere Funktion ist in einem Temperaturbereich von -55° C bis +125° C gegeben.

Mit der Kabelkonfektions-**Serie 998-916** erweitert W+P das Portfolio als Version mit IDC Anschluss-Technik, sie ist beidseitig konfektioniert erhältlich. Vier verschiedene Ausrichtungen des Steckgesichtes sind möglich, des Weiteren ist die Länge des Flachbandkabels anwendungsgerecht frei wählbar, hier liegt der Aderquerschnitt bei AWG 30. Passend zu den oben genannte B-t-B Serien ist die zweireihige Schneid-Klemm-Buchse gleichfalls in 10 verschiedenen Polzahlen lieferbar. Als Kontaktmaterial steht eine Kupferlegierung mit einer Gold-Oberfläche von 0,75 µm zur Verfügung. Hier wird der Isolierkörper aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff gemäß UL94 V-0 angeboten, der geeignete Temperaturbereich reicht von -20° C bis +105° C.

Optimale Einsatzgebiete sind Verbindungen von Leiterplatten und Anschlüsse interner sowie externer Geräte. Zu finden beispielsweise im Embedded Computing Bereich, Automatisierungstechnik und in industriellen Anwendungen.

Muster und Datenblätter der Serien sind kostenlos erhältlich.